

杭州士兰微电子股份有限公司

2022 校园招聘

士兰微 (600460) 坐落于杭州高新技术产业开发区, 是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业。士兰微成立于1997年10月, 总部在中国杭州。2003年3月士兰微股票在上海证券交易所挂牌交易, 是第一家在中国境内上市的集成电路芯片设计企业。截至2016年年底, 士兰微拥有净资产约24.8亿元人民币, 总资产超过50亿元人民币, 现有的总股本数为124717万股。2020年, 士兰微的营业收入达到48.2亿元。

士兰微的技术与产品涵盖了消费类产品的众多领域, 在多个技术领域保持了国内领先的地位(如以光盘伺服为核心的数字音视频技术、绿色电源芯片技术、高压智能功率模块技术、特种半导体分立器件技术等), 在特殊工艺尤其是高压集成电路工艺领域, 已取得了领先的技术与产品研发成果。士兰微目前的产品和研发投入主要集中在以下三个领域:

基于士兰微电子集成电路芯片生产线的双极、BICMOS和BCD工艺为基础的高压、高功率、高频特殊工艺的集成电路、分立器件和微机电(MEMS)产品。

应用于消费类数字音视频系统的集成电路产品, 包括以光盘伺服为基础的数字音视频soc芯片和系统、车载多媒体芯片和系统以及视频监控芯片和系统等。

应用于显示屏的高可靠红、绿、蓝三基色led芯片和器件; 应用于半导体照明的高亮度白光led芯片和器件。

士兰微电子高度重视研发的投入和技术的积累, 现已拥有国内一流的设计研发团队和博士后科研工作站, 并聚集了一批高水平、掌握了多方面核心技术的研发骨干, 拥有研发人员400余人, 博士、硕士200余人。士兰微陆续承担了国家01、02科技重大专项、科技部“863”计划、国家发改委的高技术产业化、工信部电子信息产业发展基金、杭州市重大科技创新专项等项目。

在行业深耕多年, 持续的技术创新机制和追求卓越的精湛管理为士兰微电子带来了多项荣誉, 士兰微电子连续多年入围“中国十大集成电路设计企业”、“中国软件业务收入前百家企业”、“十大中国IC设计公司品牌”, 被评为“中国十强半导体企业”、“全国五一劳动奖状”、“浙江省名牌产品”、“2016年度国家科学技术进步奖二等奖”、“2017年杭州市科学技术进步一等奖”等荣誉称号。

士兰微电子将以不断发展的电子信息产品市场为依托, 抓住全球集成电路产业结构调整机遇, 以半导体、集成电路产品为主业, 设计与制造并举, 强化投入、扩大产业基础。士兰微电子有信心在不远的将来发展成为国内主要的、综合型的半导体集成电路设计与制造企业之一, 并努力向国际知名品牌的集成电路企业迈进!

士兰微电子将为您提供良好的福利待遇, 并为优秀人才搭建了良好的发展平台, 在这儿, 您将接触到领先的产品技术、富有激情的工作团队。竭诚欢迎您加入士兰微电子, 展示您的青春活力, 发挥您的聪明才智。

杭州士兰微电子股份有限公司为员工提供具有高竞争性的薪酬待遇，奖励那些为公司做出杰出贡献的高素质员工，鼓励他们的杰出表现与进取精神，公司具备一整套完善的薪资、福利体系，以期在同行业中取得并保持自己的竞争力、奖励并激励优秀的员工，并能使每位员工都能充分享受工作的愉悦和生活的乐趣。

1、薪资项目：除约定的月工资外，公司还提供其他相关的薪资项目：项目奖金、年终奖、销售激励奖、设计提成奖、技术进步奖、质量考核奖等。

2、福利项目：

法定福利项目：高温费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及职工住房公积金；

医疗方面：公司为工作满一定年限的员工提供补充门诊和住院的商业保险；每年定期安排员工进行健康体检；

福利方面：节假日礼品慰问、礼金发放；员工生日祝福及蛋糕礼券；探亲费用报销；丰富“时髦”的日常活动；春节迎新晚会；

住宿安排：公司为在滨江测试工厂工作的员工提供集体宿舍；

员工食堂：公司建有员工食堂，对所有员工提供一日三餐服务，公司每月提供餐费补贴，滨江测试工厂提供夜宵服务；

各种兴趣协会经费支持：篮球、羽毛球、乒乓球、桌球、登山、足球、游泳、摄影.....

3、假期安排：公司为员工提供带薪年假、带薪病假以及国家规定的婚假、产假、护理假等；公休及法定假日按国家有关规定执行。

4、培训安排：公司注重员工的培养与发展，建立了完善的内部职称评审体系以及形式多样、内容丰富和工作高度关联的系统化培训计划。

2022 校园招聘 联系人

人力资源部 雷琦

13868113376（同微信）

057188212577

hr@silan.com.cn

简历投递时邮件标题（2021-岗位名称-工作地点-学校-姓名）

2022 年校招岗位

序号	岗位	研究方向	基本要求	学历	工作地点
1	博士后研究员/技术专家	功率器件设计、MEMs 结构及工艺开发、模拟芯片设计、数字芯片设计、功率系统应用、电机控制、智能控制、嵌入式软件、算法等	微电子、集成电路、电力电子等相关专业博士	博士	杭州
2	MEMs 结构及工艺工程师	加速度计、陀螺仪、光感、硅麦、压力传感等	微机电系统相关专业	硕/博	杭州
2	器件设计师	IGBT、MOSFET	微电子相关专业	硕/博	杭州
3	功率器件产品工程师	IGBT、MOSFET	微电子相关专业	硕士	杭州
4	器件及 IC 失效分析工程师	IGBT、MOSFET、数字电路、模拟电路、MEMs	微电子相关专业	硕士	杭州
5	IC 封装工程师	IC 和功率器件	微电子学、物理学、材料加工工程、电子封装等相关专业	硕士	杭州
3	模拟 IC 设计师	电源管理、栅驱动、IPM、混合信号	集成电路设计、电路与系统、微电子学与固体电子学等	硕/博	杭州、成都、西安、无锡、上海
4	数字 IC 设计师	数字 IC 前端、数字 IC 验证、数字 IC 综合	集成电路设计、电路与系统、微电子学与固体电子学等	硕士	杭州、无锡
5	系统设计师	功率系统、电源系统、电机控制、工控系统	电路与系统、电力电子、控制类、电机类等	硕/博	杭州
6	嵌入式软件设计师	电源系统、工控系统、电机驱动、音频系统、MEMs	电路与系统、电力电子、控制类、电机类等	硕	杭州
7	硬件设计师 (芯片应用)	电源系统、电机驱动、功率器件、MEMS、IPM	电子类相关专业	本/硕	杭州
8	芯片版图设计师	IC 电路版图	微电子、电子类相关专业	本科	杭州
9	IC 测试方案开发工程师		电子类相关专业	本/硕	杭州
10	质量工程师		微电子、电子类相关专业	本/硕	杭州
11	现场应用工程师		微电子、电子类相关专业	本/硕	杭州、深圳
12	销售工程师		电子类相关专业	本科	杭州、深圳

职位描述

技术专家（博士） 工作地点：杭州

士兰微电子有国家级博士后科研工作站，欢迎功率器件设计、半导体封装设计、MEMs 结构及工艺开发、模拟芯片设计、数字芯片设计、功率系统应用开发、电机控制系统开发等和公司业务相关的各类博士人才加入。

器件设计师 工作地点：杭州

工作职责：

- 1) 和模拟电源产品工程师紧密配合，参与产品定义；根据产品构架定义功率器件特性和参数；
- 2) 和器件产品线配合，参与产品定义；根据产品构架定义分离功率器件特性和参数；
- 3) 和 TD 工程师配合，在现有工艺平台上，设计核心功率器件，模拟器件特性，分析评价流片结果；
- 4) 和 TD 工程师配合，开发新的工艺平台，设计分立功率器件，模拟器件特性，分析评价流片结果；
- 5) 根据产品需求围绕功率器件进行功能模块设计；
- 6) 收集产品需求，不断调整器件参数，满足产品需求，维护器件工艺平台和功率模块；
- 7) 对失效的产品进行器件分析，定位失效的根本原因。

岗位要求：

- 1) 微电子、集成电路设计相关专业硕士及以上学历；
- 2) 具备良好的功率器件（MOSFETs、IGBT、Rectifiers、JFET）设计基础；
- 3) 熟悉功率器件的 DC - DC；AC - DC 应用；
- 4) 良好的电路分析能力；
- 5) 良好的团队合作能力和沟通能力；
- 6) 独立分析能力和清晰文档表达能力。

岗位方向：

器件设计师（高低压 MOSFET）

器件设计师（IGBT）

工艺平台开发

产品工程师 工作地点：杭州

工作职责：

- 1) 产品定义，包括市场可行性评估，参数评估，封装评估，可靠性评估，中成测覆盖率评估，整机匹配性评估，及量产前的生产安排；
- 2) 产品管理，按产品族整理存在问题与解决方案，性能提升计划与安排；
- 3) 竞品分析与评价；
- 4) 规格书制作与审核；
- 5) 客户需求处理；客户走访支持与交流。

岗位要求：

硕士学历，微电子相关专业，有功率器件（MOSFET、IGBT）相关产品的器件设计或工艺开发等相关工作经验。

器件失效分析工程师（FA） 工作地点：杭州

工作职责：

- 1) 对公司产品的客户反馈,生产异常,可靠性失效,新品失效等异常进行失效分析,提出建议改进方案,并出具失效分析报告;

2) 协助产品线, 运用各种技术工具和质量工具, 对产品进行失效预防。

岗位要求:

- 1) 硕士学历, 微电子专业, 有功率器件或电路分析经验, 对器件结构有比较全面深刻的认知。
- 2) 希望具备如下技能一种或多种经验: 失效分析经验、流片相关经验、封装相关经验、测试相关经验。

IC 封装设计工程师 工作地点: 杭州

工作职责:

- 1) IC 封装方案设计评估, 协调内外资源为公司提供低成本、高可靠性的封装方案;
- 2) 和芯片工程师配合, 完成封装外形设计, 引线框架设计, 基板布局设计等, 确保封装设计最优化;
- 3) 封装参数提取、热仿真及应力仿真;
- 4) 与晶圆制造商和封装厂沟通, 协同解决制造过程中出现的问题, 保证项目进度;
- 5) 协同封装厂改进和优化工艺技术。

岗位要求:

- 1) 硕士学历, 微电子学、电子信息与科学、物理学、材料学、材料加工工程、电子封装等相关专业;
- 2) 熟悉各种封装工艺设备, 了解各种封装材料特性, 有大型封装厂相关实习经验优先;
- 3) 开发过电源产品封装, 具有 FC 封装、CLIP 封装经验者优先;
- 4) 熟练使用热仿真工具及结构设计软件人员优先;
- 5) 具有非常清楚的逻辑思维, 良好的协调沟通能力, 能够承受一定的工作压力;
- 6) 良好的英语读写能力。

封装仿真工程师 工作地点: 杭州

岗位职责:

- 1) 通过封装电、热、应力及可靠性仿真, 指导 IC 封装正向设计;
- 2) 预研国内外先进封装技术, 为公司产品提供新型封装方案;
- 3) 获取 IC 设计人员封装需求, 协调公司内外封装资源, 为公司产品选取低成本、高可靠性封装方案。
- 4) 与晶圆制造商和封装厂沟通, 协同解决制造过程中出现的问题, 保证项目进度;

岗位要求:

- 1) 硕士学历, 微电子学、电子信息与科学、物理学、材料学、材料加工工程、电子封装等相关专业;
- 2) 熟悉常用的仿真软件和工具, 对半导体器件、IC 仿真有一定的了解
- 3) 具有非常清楚的逻辑思维, 良好的协调沟通能力, 能够承受一定的工作压力;
- 4) 良好的英语读写能力。

MEMS 结构及工艺工程师 工作地点: 杭州

工作职责:

- 1) MEMS 传感器研发; 有加速度计、陀螺仪、光感、硅麦、压力传感等相关经验均可;
- 2) MEMS 结构模拟仿真、工艺流程设计与优化。

岗位要求: 微机电系统相关专业硕士学历, 至少熟悉以上一类传感器的结构及工艺。

模拟 IC 设计师 工作地点: 杭州、成都、西安、无锡、上海

工作职责:

- 1) 负责模拟 IC 产品的线路设计;
- 2) 协助版图设计师完成 IC 的版图设计;

- 3) 协助测试工程师完成 IC 的测试验证;
- 4) 负责产品的技术资料编写。

岗位要求:

- 1) 硕士及以上学历, 微电子类及相关专业;
- 2) 模拟电路基础知识扎实;
- 3) 了解模拟版图设计流程和 BiCMOS/BCD 工艺流程;
- 4) 思路清晰, 具备良好的分析能力和学习能力;
- 5) 工作态度严谨, 具有良好的沟通、表达能力, 注重团队合作; 有相关研发经验者优先。

岗位方向:

- 1) 模拟 IC 设计师 (低压栅驱动)
- 2) 模拟 IC 设计师 (高压栅驱动)
- 3) 模拟 IC 设计师 (IPM)
- 4) 模拟 IC 设计师 (电源管理 ACDC、DCDC)
- 5) 模拟 IC 设计师 (混合信号)
- 6) 模拟 IC 设计师 (模拟 IP 开发)

数字 IC 设计师 工作地点: 杭州、无锡

工作职责:

根据产品定义完成模块设计、系统设计; 负责项目 RTL 编码、综合、验证、时序分析; 负责输出流片以及设计使用说明书等文档编写工作。

岗位要求:

- 1) 微电子、集成电路设计相关专业硕士学历;
- 2) 熟练掌握 VLSI 设计流程。

岗位方向:

- 1) 数字 IC 设计师 (MCU)
- 2) 数字 IC 设计师 (MEMS)

系统应用工程师 工作地点: 杭州

岗位方向 1: 系统应用工程师 (电机驱动)

工作职责:

- 1) 配合产品工程师针对产品的关键功能及性能指标制定相关系统测试方案, 完成配套嵌入式软件开发, 形成完产品认定报告;
- 2) 配合算法及系统工程师针对核心算法开发软件进行相关原理及验证及工程化移植;
- 3) 收集同类主流产品及方案信息, 开展专项对比、系统评价工作, 及时沟通及整理目标客户、细分行业下一代产品关键需求, 形成正式文档, 并配合产品经理、研发经理、应用经理做好相关产品、技术平台、及配套应用系统方案规划;
- 4) 协助业务或销售平台及时跟踪好大客户进展, 作好相关渠道 (含方案公司、代理商等) 及目标客户对应人员的技术支持及培训工作。

岗位要求:

- 1) 电力电子、测控、电机、自动化、通信等相关专业硕士及以上学历;
- 2) 具备良好的模拟电路、数字电路设计基础, 对产品系统中的 IC、功率器件等硬件电路有一定的了解;
- 3) 熟悉嵌入式软件编程 (包括汇编及 C 语言); 精通至少一种 MCU (单片机)、DSP (数字处理器)、ARM 平台及相关项目软件开发。

岗位方向 2:

- 1) 系统应用工程师 (电源管理)
- 2) 系统应用工程师 (分立器件、功率模块)

工作职责:

- 1) 研究和开发电源功率系统, 跟踪功率领域的最新技术
- 2) 定义电源管理芯片和功率器件, 编写设计文档和技术资料
- 3) 根据市场信息和客户需求, 应用电源管理芯片和功率器件, 开发方案

岗位要求:

- 1) 电力电子、电机、自动化等相关专业本科及以上学历
- 2) 有扎实的电力电子技术基础, 熟悉控制理论、功率器件应用、磁元件设计等
- 3) 熟悉嵌入式软件编程, 熟悉 MCU (单片机) 或 DSP (数字处理器) 的开发
- 4) 思路清晰, 具备良好的分析能力和学习能力;
- 5) 工作态度严谨, 具有良好的沟通、表达能力, 注重团队合作。

嵌入式软件设计师 工作地点: 杭州

1) 嵌入式软件设计师 (电源方向)

工作职责:

1. 软件系统架构设计及优化;
2. 驱动设计及调试;
3. 功能模块开发及调试;
4. 产品开发支持。

岗位要求:

1. 硕士学历, 信电类相关专业;
2. 精通 C 语言;
3. 理解计算机体系结构;
4. 熟悉嵌入式操作系统原理;
5. 熟悉电子线路及原理;
6. 有数控电源, 快充, 移动充电等电源类嵌入式项目开发经验优先。

2) 嵌入式软件设计师 (工控方向)

岗位职责及工作内容:

1. 根据需求设计功率控制系统嵌入式软件。
2. 调试并优化系统软件。
3. 根据测试及需求反馈优化软件程序。
4. 程序代码的封装, 相关设计文档建立。
5. 程序算法研究及实现。

岗位要求:

1. 计算机、电子信息、电气工程及其自动化相关专业学历。
2. 熟悉 MCU、DSP 等开发平台, 熟悉 C/C++ 和汇编等编程语言, 有相关产品开发经验者优先。
3. 具备良好的沟通能力, 清晰的设计思路。
4. 具备良好, 严谨的程序代码设计风格。

5. 能够和系统硬件工程师及算法工程师充分沟通，密切合作。
6. 有系统模型或者仿真经验尤佳。
7. 有功率控制系统嵌入式软件设计经验尤佳。

3) 嵌入式软件设计师 (传感器方向)

岗位职责:

1. 负责公司 motion Sensor 产品的驱动, 应用, 系统软件开发。
2. 配合算法工程师开发验证 Sensor 相关的算法。
3. 配合芯片部门进行芯片应用级的测试对比。

职位要求:

1. 电子/通信/计算机/自动控制等相关专业本科或以上学历。
2. 工作态度积极, 为人踏实, 身体健康, 乐观向上, 具有良好的沟通和协调能力。
3. 熟悉嵌入式软件编程, C 语言编程, 模电, 数电, 具有较强的独立分析问题, 解决问题的能力。
4. 能够熟练阅读和理解英文资料, 能够适应英语环境下工作。

研发质量工程师 工作地点: 杭州

工作职责:

1. 全程参与产品研发过程, 负责产品研发的质量策划及检查落实
2. 负责主导产品生产过程中质量问题的分析及处理
3. 负责主导产品售后质量问题的分析及处理
4. 负责整理总结质量相关经验数据库, 形成产品研发及生产过程的 checklist 检查表并落实

岗位要求:

1. 本科及以上学历, 电子相关专业, 对半导体产品设计、测试有一定的了解;
2. 有较强的学习能力, 善于沟通, 思路清晰, 逻辑性强, 责任心强。

IC 应用方案开发工程师 (硬件) 工作地点: 杭州

工作职责: 负责芯片应用系统方案的设计, 配合客户进行系统方案的测试。

岗位要求:

1. 本科, 熟悉电子电路(模拟/数字)设计, 熟练掌握相关的电路设计软件;
2. 熟悉以下至少一种芯片的系统方案设计: 功率器件、电机驱动、IPM 模块、MEMS 传感器、电源管理。

芯片版图设计师 工作地点: 杭州

工作职责:

1. 根据公司和设计所研发任务的需求, 在后端设计部经理的任务分派和其他设计师要求下, 独立完成根据前端设计师提供的线路进行版图的全定制版图设计或简单的布局布线;
2. 负责对设计的版图和线路或网表数据进行验证;
3. 根据前端设计师提供的网表进行全定制版图布局、参数提取、版图处理;
4. 在相关设计师指导下, 完成版图数据输出及相关表单的申请制作。

岗位要求: 本科以上学历, 电子类相关专业; 有模拟版图相关经验或者与兴趣从事模拟版图工作。

IC 测试方案开发工程师 工作地点: 杭州

工作职责:

1. 参与产品的可测试性设计需求提交;

2. 负责新品从研发走向量产的测试开发和导入工作，保证设计和生产的有效衔接；
3. 负责集成电路新品测试方案开发（包括测试程序、测试卡的开发和调试）；
4. 负责新品转批量和已量产产品的技术支持、生产保障；
5. 负责产品合格率提升和测试效率提升相关工作；
6. 负责测试相关的制造流程、软件的改进；
7. 负责量产产品异常批次及客户反馈品的失效分析；
8. 支持产品质量相关问题分析，推动产品流片工艺、封装质量等提高；
9. 支持产品可靠性测试相关测试技术分析工作；

岗位要求：

1. 本科以上学历，电子类或相关专业，英语 CET-4；
2. 有集成电路测试相关工作经验优先。

质量保障工程师 工作地点：杭州

工作职责：

1. 推进产品的前期产品质量策划、FMEA 和控制计划；
2. 负责产品的生产过程产生异常分析推进和物流处理、测试项目评审、转批量评审等事务处理，以及对产品隔离和启用，处理和审核；
3. 对产品开发、流片、封装、测试等过程发生的问题以及客户反馈的问题进行跟进，推进制定纠正预防措施，并跟踪验证改善效果；
4. 客诉处理，客户需求支持，客户退换货以及索赔等流程处理。

岗位要求：

1. 微电子或相关专业，本科及以上学历，优秀的硕士生尤佳；
2. 熟悉集成电路的生产、测试流程及基本原理；
3. 了解基本的芯片流片、封装和测试工艺知识；
4. 具有较强的计划性和实施执行能力，以及抗压能力。

现场应用工程师 杭州、深圳

岗位职责与岗位要求：

1. 电子类相关专业本科以上学历；
2. 有嵌入式开发系统、功率器件、模拟电路等相关研发背景均可；
3. 有较强的电路调测经验和动手能力,能熟练使用各种常用的电子仪器；
4. 能帮助客户解决产品应用过程中发生的技术问题，并根据客户要求提供现场支持；
5. 了解客户在技术上的发展要求及方向,并解答客户提出的各类产品技术相关问题；
6. 具备独立开展工作的能力，以及灵活的现场反应能力、沟通能力。

销售工程师 工作地点：杭州、深圳

岗位要求：

1. 电子类、自动化、控制类、计算机类相关专业本科学历；
2. 对消费类电子有一定的敏锐度，对功率器件的应用比较了解，对电源、电机、白电等整机系统有基本的了解；
3. 具备较强的沟通能力和市场开拓能力；
4. 有责任心、具备较强抗压能力；

5. 能独立完成市场情况分析、并指定相应的市场计划、策略等;
6. 在校期间担任学生会、社团主要学生干部经验优先;
7. 有销售实际经验的优先。

~~~~~

以下空白